

Gowin PicoRV32 快速设计 参考手册

IPUG915-1.3,2021-07-16

版权所有 © 2021 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云, W, Gowin, GowinSynthesis, 高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标, 本手册中提到的其他任何商标, 其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可,任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明	
2020/01/16	1.0	初始版本。	
2020/03/13	1.1	 MCU 支持 Wishbone 总线接口的外部设备 GPIO; MCU 支持扩展 AHB 总线接口; MCU 支持片外 SPI-Flash 下载及运行; MCU 支持外部设备 SPI-Flash 读、写和擦除功能; MCU 支持 Hardware Stack Protection 和 Trap Stack Overflow 功能。 	
2020/06/01	1.2	● 支持 MCU 软件在线调试功能;● 增强 MCU 内核中断处理功能;● 优化 MCU 内核指令。	
2021/07/16	1.3	● 删除综合工具 SynplifyPro;更新 FPGA 软件版本。	

目录

目	录…		. i
图	目录	<u> </u>	ii
表	目录	£i	ii
1	参考	'设计	1
	1.1	软件参考设计	1
	1.2	硬件参考设计	1
2	软件	参考设计	2
	2.1	软件环境	2
	2.2	导入软件参考设计	2
	2.3	软件配置	2
	2.3	.1 Boot Mode 配置	3
	2.3	.2 Flash 链接器配置	3
		编译	
		下载	
		参考手册	
3	硬件	:参考设计	6
	3.1	硬件环境	6
	3.2	软件环境	6
	3.3	导入硬件参考设计	6
	3.4	综合	7
		布局布线	
		下载	
	3.7	参考手册	9

图目录

图 2-1 导入软件参考设计	2
图 2-2 Boot Mode 配置	
图 2-3 Flash 链接器配置	
图 2-4 编译	
图 2-5 打开下载工具 Programmer	4
图 2-6 Device configuration	5
图 3-1 导入硬件参考设计	6
图 3-2 综合硬件参考设计	7
图 3-3 布局布线	7
图 3-4 Device configuration	8

表目录

表 3-	1 研供会学设计学例	 7
-C ∨	1 ლ件参考设计示例	 •
<i></i>		

IPUG915-1.3 iii

1.5 教子设计 1.1 软件参考设计

1 参考设计

1.1 软件参考设计

Gowin_PicoRV32 提供 GOWIN MCU Designer(V1.1 及以上版本)软件环境的软件编程参考设计。通过链接获取如下参考设计:

1.2 硬件参考设计

Gowin_PicoRV32 提供高云云源软件(V1.9.8Beta 及以上版本)的硬件参考设计。通过链接获取如下<u>参考设计</u>:

Gowin_PicoRV32\ref_design\FPGA_RefDesign\DK_START_GW2A18 V2.0\gowin picorv32

IPUG915-1.3 1(9)

2 软件参考设计 2.1 软件环境

2 软件参考设计

2.1 软件环境

● GOWIN MCU Designer (V1.1 及以上版本),通过链接获取如下参考设计: http://cdn.gowinsemi.com.cn/GMD V1.1.zip

注!

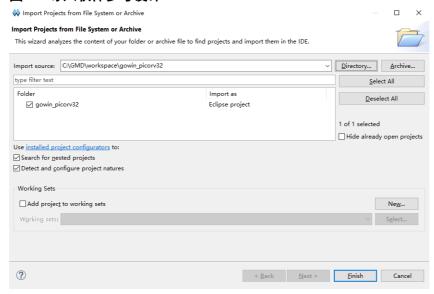
与当地高云技术支持联系获取 GOWIN MCU Designer license。

2.2 导入软件参考设计

以软件开发工具包参考设计为例。

双击打开 GOWIN MCU Designer,选择菜单栏 "File > Open Projects from File System...",选择软件编程参考设计 gowin_picorv32,单击"Finish",导入软件编程参考设计 gowin picorv32,如图 2-1 所示。

图 2-1 导入软件参考设计



2.3 软件配置

以软件开发工具包参考设计为例。

硬件参考设计 gowin_picorv32 的 ITCM 配置选项中, 配置启动和运行方

IPUG915-1.3 2(9)

2.3 软件配置

式为 MCU boot from external Flash and run in ITCM。

2.3.1 Boot Mode 配置

因为硬件参考设计启动和运行方式为 MCU boot from external Flash and run in ITCM,所以软件编程参考设计 gowin_picorv32 的 config.h 配置文件中,定义启动和运行方式的宏定义为 BUILD_BURN(#define BUILD MODE BUILD BURN),如图 2-2 所示。

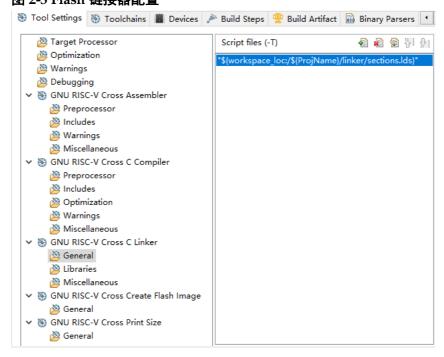
图 2-2 Boot Mode 配置

2.3.2 Flash 链接器配置

因为硬件参考设计启动和运行方式为 MCU boot from external Flash and run in ITCM,所以软件 Flash 链接器配置选项 "GNU RISC-V Cross C Linker > General > Script files (-T)",选择 sections.lds 作为 Flash 链接器。

Flash 链接器配置,如图 2-3 所示。

图 2-3 Flash 链接器配置



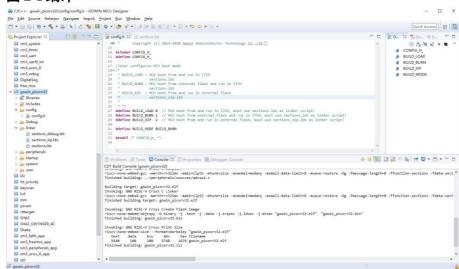
IPUG915-1.3 3(9)

2 软件参考设计 2.4 编译

2.4 编译

单击工具栏编译按钮 "**^**",编译软件参考设计,产生软件设计二进制 BIN 文件,如图 2-4 所示。

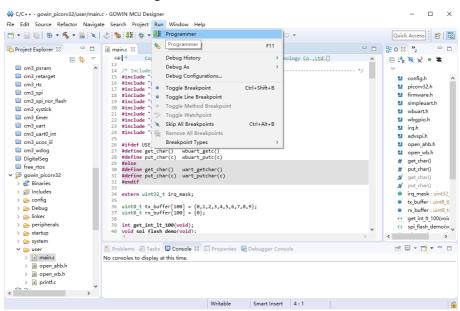
图 2-4 编译



2.5 下载

单击菜单栏 "Run > Programmer"或工具栏 Programmer "嗯",打开下载工具 Programmer,如图 2-5 所示。

图 2-5 打开下载工具 Programmer



单击 Programmer 菜单栏 "Edit > Configure Device" 或工具栏 "Configure Device" (》),打开 Device configuration。

● "Access Mode"下拉列表,选择"External Flash Mode"选项。

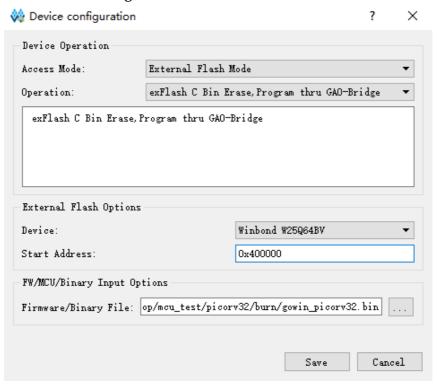
IPUG915-1.3 4(9)

2.6 参考手册

● "Operation"下拉列表,选择"exFlash C Bin Erase, Program thru GAO-Bridge"或"exFlash C Bin Erase, Program, Verify thru GAO-Bridge"选项。

- "FW/MCU/Binary Input Options > Firmware/Binary File"选项,导入需要下载的软件设计二进制 BIN 文件。
- "External Flash Options > Device"选项,根据开发板板载 Flash 芯片类型选择,如高云 DK-START-GW2A18 V2.0 开发板板载 Winbond W25Q64BV。
- "External Flash Options > Start Address"选项,设置为"0x400000"。
- 单击 "Save",如图 2-6 所示。

图 2-6 Device configuration



完成 Device configuration 后,单击 Programmer 工具栏 "Program/Configure" (),完成软件设计二进制 BIN 文件的下载。

2.6 参考手册

Gowin_PicoRV32 软件编程设计方法,请参考:

- IPUG911, Gowin PicoRV32 软件编程参考手册
- IPUG910, Gowin PicoRV32 IDE 软件参考手册
- IPUG913, Gowin PicoRV32 软件下载参考手册
- SUG502, Gowin Programmer 用户指南

IPUG915-1.3 5(9)

3.1 硬件参考设计 3.1 硬件环境

3 硬件参考设计

3.1 硬件环境

DK-START-GW2A18 V2.0: GW2A-LV18PG256C8/I7

3.2 软件环境

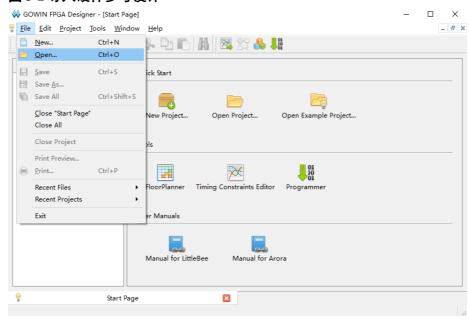
Gowin_V1.9.8Beta 及以上版本

3.3 导入硬件参考设计

以软件开发工具包参考设计为例。

双击打开高云云源软件,选择菜单栏 "File > Open...",打开硬件参考设计 $gowin_picorv32$,如图 3-1 所示。

图 3-1 导入硬件参考设计



硬件参考设计工程的 RTL 设计文件描述,如表 3-1 所示。

IPUG915-1.3 6(9)

3.4 综合

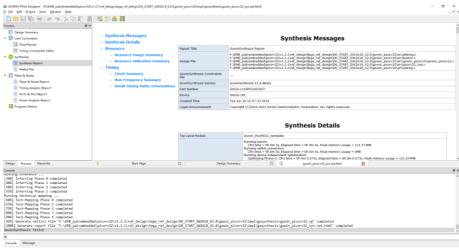
表 3-1 硬件参考设计示例

文件	描述
gowin_picorv32.v	IPCore Generator 产生的 Gowin_PicoRV32 硬件设计
picorv32_top.v	Gowin_PicoRV32 Top Module 实例化和用户设计
wbreg.v	Open Wishbone 总线扩展外部设备示例
ahbreg.v	Open AHB 总线扩展外部设备示例
button.v	外部中断示例
picorv32.cst	物理约束

3.4 综合

运行综合工具 GowinSynthesis[®],综合硬件参考设计,产生网表文件,如图 3-2 所示。

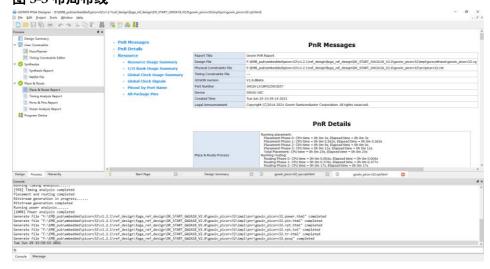
图 3-2 综合硬件参考设计



3.5 布局布线

完成综合后,运行布局布线工具 Place & Route,完成布局布线,产生硬件设计码流文件,如图 3-3 所示。

图 3-3 布局布线



IPUG915-1.3 7(9)

3.6 下载

3.6 下载

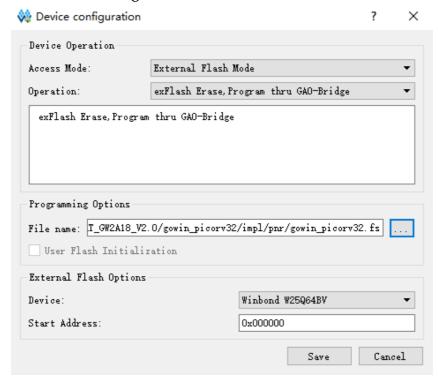
运行高云云源软件的下载工具 Programmer, 下载硬件设计码流文件。

单击 Programmer 菜单栏 "Edit > Configure Device" 或工具栏 "Configure Device" (基), 打开 Device configuration。

以软件开发工具包 DK START GW2A18 V2.0 参考设计为例。

- "Access Mode"下拉列表,选择"External Flash Mode"选项。
- "Operation"下拉列表,选择"exFlash Erase, Program thru GAO-Bridge" 或 "exFlash Erase, Program, Verify thru GAO-Bridge"选项。
- "Programming Options > File name"选项,导入需要下载的硬件设计码流文件。
- "External Flash Options > Device"选项,根据开发板板载 Flash 芯片类型选择,如高云 DK-START-GW2A18 V2.0 开发板板载 Winbond W25Q64BV。
- "External Flash Options > Start Address"选项,设置为"0x000000"。
- 单击 "Save",如图 3-4 所示。

图 3-4 Device configuration



完成 Device configuration 后,单击 Programmer 工具栏 "Program/Configure"(),完成硬件设计码流文件的下载。

IPUG915-1.3 8(9)

3.7 参考手册

3.7 参考手册

Gowin_PicoRV32 硬件设计,请参考:

- <u>IPUG914</u>, Gowin_PicoRV32 硬件设计参考手册
- SUG100, Gowin 云源软件用户指南
- <u>SUG101</u>, Gowin 设计约束指南
- <u>SUG502</u>, Gowin Programmer 用户指南

IPUG915-1.3 9(9)

